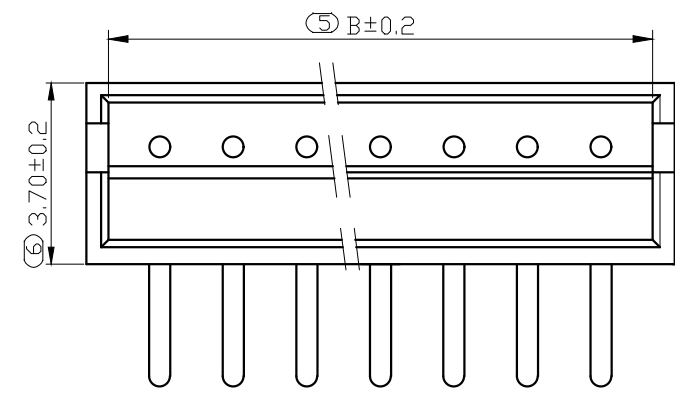
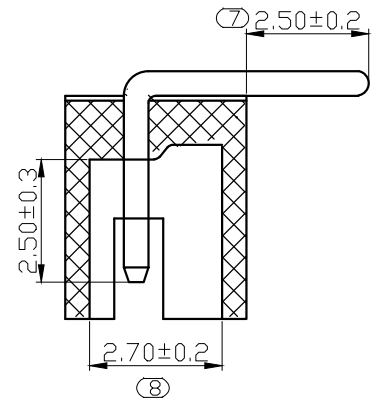
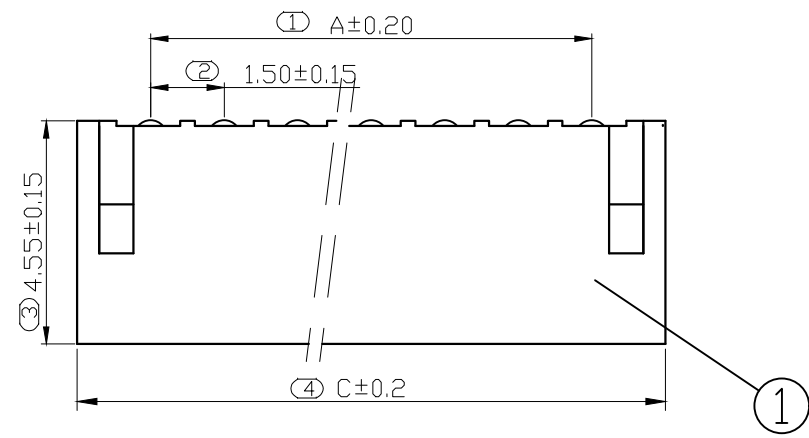


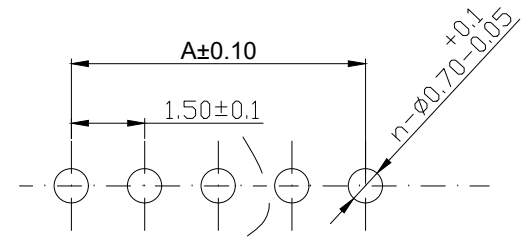
| REV. | DESCRIPTION | DATE   |
|------|-------------|--------|
| A/0  | 修订版本        | 230509 |

ROHS管理规定:  
 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。  
 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表,有效期一年。

技术指标:  
 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;  
 2、温度范围: -25° C~85° C;  
 3、额定电压: 250V, AC, DC(等效);  
 4、接触电阻: ≤0.03 Ω;  
 5、绝缘电阻: ≥1000M Ω;  
 6、耐压: 1000V, AC/minute.



| Pin位 | A    | B    | C    |
|------|------|------|------|
| 2    | 1.5  | 3.6  | 4.5  |
| 3    | 3    | 5.1  | 6    |
| 4    | 4.5  | 6.6  | 7.5  |
| 5    | 6    | 8.1  | 9    |
| 6    | 7.5  | 9.6  | 10.5 |
| 7    | 9    | 11.1 | 12   |
| 8    | 10.5 | 12.6 | 13.5 |
| 9    | 12   | 14.1 | 15   |
| 10   | 13.5 | 15.6 | 16.5 |
| 11   | 15   | 17.1 | 18   |
| 12   | 16.5 | 18.6 | 19.5 |
| 13   | 18   | 20.1 | 21   |
| 14   | 19.5 | 21.6 | 22.5 |
| 15   | 21   | 23.1 | 24   |
| 16   | 22.5 | 24.6 | 25.5 |



PCB 寸法  
PCB Layout

| 序号 | 名称         | 材料            | 数量  | 附注                                |
|----|------------|---------------|-----|-----------------------------------|
| 2  | 端子 Contact | 黄铜 Brass      | nx1 | 包膜(膜): 整件表面镀镍30u"MIN, 焊盘镀90u"MIN. |
| 1  | 基板 Wafer   | PA66(UL94V-0) | 1   | 包膜(膜): 整件表面镀镍30u"MIN, 焊盘镀90u"MIN. |

| 未注公差    |            |      | 兆星精密电子(深圳)有限公司 |       |               |         |              |
|---------|------------|------|----------------|-------|---------------|---------|--------------|
| X.° ±3° | X.X° ±0.5° |      | 单位             | 比例    | Design Units  | SIZE    | 页码           |
| <10     | 10-30      | >30  | MM Only        | ---   | METRIC        | A4      | 1 OF 1       |
| ±0.2    | ±0.25      | ±0.3 | 材料             | 图号    | ZX-ZH1.5-WZ3P | Part No |              |
| 制作      | 审核         | 批准   | Lin L          | Lin R | Lin R         | 品名      | ZH1.50 弯针 3P |

旧底图总号  
底图总号  
签字  
日期